



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) **EP 1 368 826 A2**

(43) Date of publication:
10.12.2003 Bulletin 2003/50

(21) Application number: 02717453.1

(22) Date of filing: 19.02.2002

(51) Int. Cl.⁷ **H01L 21/321**

(86) International application number:
PCT/US02/04806

(87) International publication number:
WO 02/075804 (26.09.2002 Gazette 2002/39)

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE TR

(30) Priority: 14.03.2001 US 275874 P
24.04.2001 US 286107 P
01.10.2001 US 326263 P
03.01.2002 US 38066

(71) Applicant: Applied Materials, Inc.
Santa Clara, California 95054 (US)

(72) Inventors:
, CHEN, Liang-Yuh,
Foster City, CA 94404 (US)
, HSU, Wei-Yung,
Santa Clara, CA 95054 (US)

, DUBOUST, Alain
Sunnyvale, CA 94086 (US)
, MORAD, Ratson
Palo Alto, CA 94306 (US)
, CARL, Daniel, A.
Pleasanton, CA 94566 (US)
, SOMEKH, Sasson
Los Altos Hills, CA 94022 (US)
, MAYDAN, Dan
Los Altos Hills, CA 94022 (US)

(74) Representative:
Bayliss, Geoffrey Cyril et al
BOULT WADE TENNANT,
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
London WC1X 8BT (GB)

(54) **PLANARIZATION OF SUBSTRATES USING ELECTROCHEMICAL MECHANICAL POLISHING**

(87) This International application for which the EPO is a designated office has not been republished by the EPO according to article 158(1) EPC.

Cette demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné n'a pas été republiée par l'OEB en vertu de l'article 158(1) CBE.

Diese internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, würde, gemäß Artikel 158(1) EPÜ, vom EPA nicht wieder veröffentlicht.

EP 1 368 826 A2